

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2022-040

杭州集智机电股份有限公司

关于向银行申请综合授信融资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信融资概述

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第四届董事会七次会议审议通过的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请授信额度4亿元，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期项目借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。同时，提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本议案已经2022年4月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，具体情况请详见公司分别于2022年3月23日、2022年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。

二、本次授信融资进展情况

近日，根据公司业务发展的需要以及新基建项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行等银行金融机构申请项目贷款，总额度为人民币2.8亿元的项目授信额度，具体授信融资及抵押事项如下：

公司将名下位于西湖区杭政工出【2021】19号新制造业项目（集智港）的土地使用权（土地面积为18367平方米）以及后续项目建成后地上建筑用于抵押给办理项目贷款的上述银行金融机构。本次授信额度人民币2.8亿，用于西湖区杭政工出【2021】19号新制造业项目（集智港）项目建设，土地使用权以及地上建筑抵押期限以实际签署的相关协议为准。

本次融资额度已经公司2022年第一次临时股东大会批准，授权公司董事长楼荣

伟先生或其指派的相关人员办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

三、交易的目的及影响

本次向银行融资及抵押事项，符合公司实际生产经营和发展的需要，本次融资能够更好地促进项目开展，促进公司的经营发展，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2022年5月27日